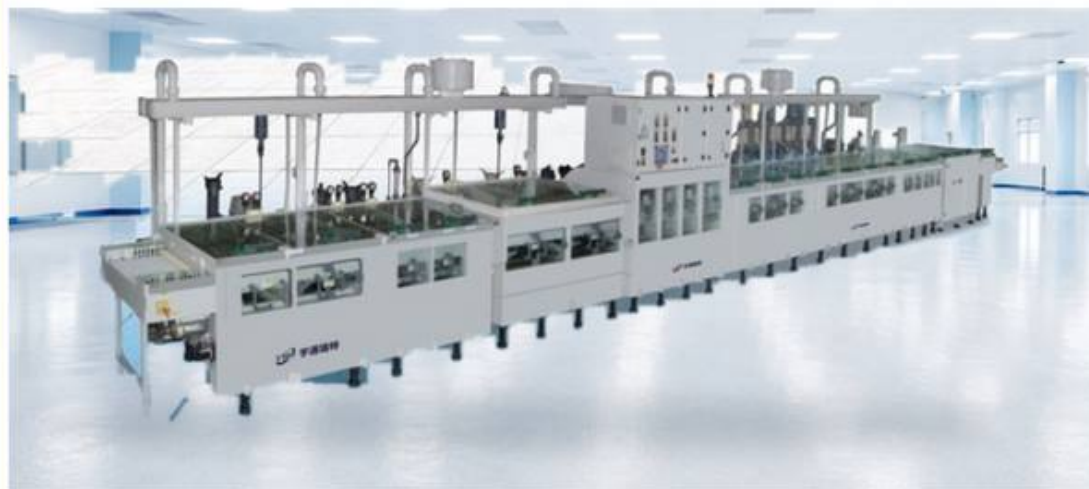


ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Горизонтальные и вертикальные линии мокрых процессов
для PCB, FPCB, керамических подложек и полупроводников.



НАДЁЖНОСТЬ

Стабильные процессы

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Интеграция с MES

СЕРВИС

Поддержка и обучение

СТАНДАРТНОЕ МИКРОТРАВЛЕНИЕ



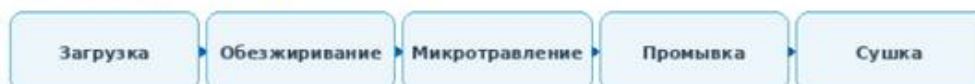
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Независимая качающаяся система распыления.
- Многоступенчатая фильтрация раствора.
- Специальные сопла обеспечивают равномерную обработку.
- Стабильная микроструктура и высокая адгезия.
- Интеграция с MES.

НАЗНАЧЕНИЕ

Контролируемое снятие меди и формирование равномерной микрошероховатости.

ТИПОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МАРШРУТ



УСИЛЕННОЕ МИКРОТРАВЛЕНИЕ

10



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Усиленная зона распыления и повышенное давление.
- Равномерная глубокая микроструктура поверхности.
- Фильтрация и стабилизация параметров раствора.
- Контроль величины снятия меди.
- Интеграция с MES.

НАЗНАЧЕНИЕ

Усиленная подготовка меди перед ламинированием, паяльной маской или финишным покрытием.

ТИПОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МАРШРУТ

